

贴片封装 5.0×3.2mm 压控晶体振荡器

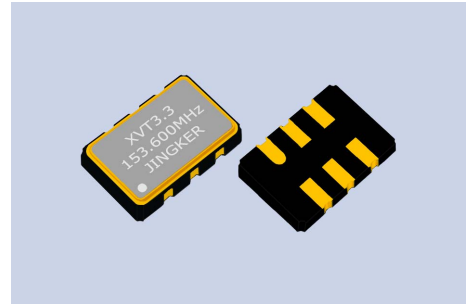


产品特点:

- 采用 AT 切片晶体, 频率稳定性高, 无倍频, 输出信号抖动低
- 启动速度快, 消耗电流低
- 军品级工作温度范围, 可靠性高, 抗震动能力强
- 符合 RoHS, 无铅指令产品

应用范围:

- 电脑周边产品, 电子通信设备, 测试设备, 仪器仪表
- 光传输设备, 通信基站, 北斗导航, 定位搜索, 电台发射接收
- 短波超短波微波通信, 集群通信, 抗干扰通信
- 广泛应用于国防军事装备领域, 高等级雷达航空航天卫星通信



技术规格:

项目	规格				条件
	最小值	典型值	最大值	单位	
频率范围	0.200		200.000	MHz	
标称频率		153.600		MHz	客户指定
初始频率准确度	±5.0		±50	ppm	
温度频率稳定度	±5.0		±50	ppm	请参照表 1
年老化率			±3.0	ppm	
工作电压	3.15	3.3	3.45	V	5.0V, 2.5V, 1.8V 可选
工作电流			10	mA	F=0.2MHz~20MHz
			30	mA	F=20MHz~50MHz
			40	mA	F=50MHz~200MHz
待机电流			10	uA	
输出波形	CMOS, TTL				
负载		15		pF	输出波形 CMOS, TTL
输出高电平	90%			V _{cc}	输出波形 CMOS, TTL
输出低电平			10%	V _{cc}	输出波形 CMOS, TTL
占空比	45		55	%	输出波形 CMOS, TTL
上升/下降时间			10	ns	F=0.2MHz~20MHz
			6	ns	F=20MHz~50MHz
			3	ns	F=50MHz~200MHz
相位抖动			5.0	ps.rms	BW=12KHz~20MHz
起振时间		2	10	ms	
压控电压	0.5	2.5	4.5	V	电源电压=5V
	0.3	1.65	3.0	V	电源电压=3.3V
压控范围	±50		±200	ppm	
线性度			±10	%	
调频带宽	10			KHz	@-3dB
输入阻抗	50			KΩ	F _m <10KHz
工作温度范围	-40		+85	°C	
储存温度范围	-55		+125	°C	

贴片封装 5.0×3.2mm 压控晶体振荡器

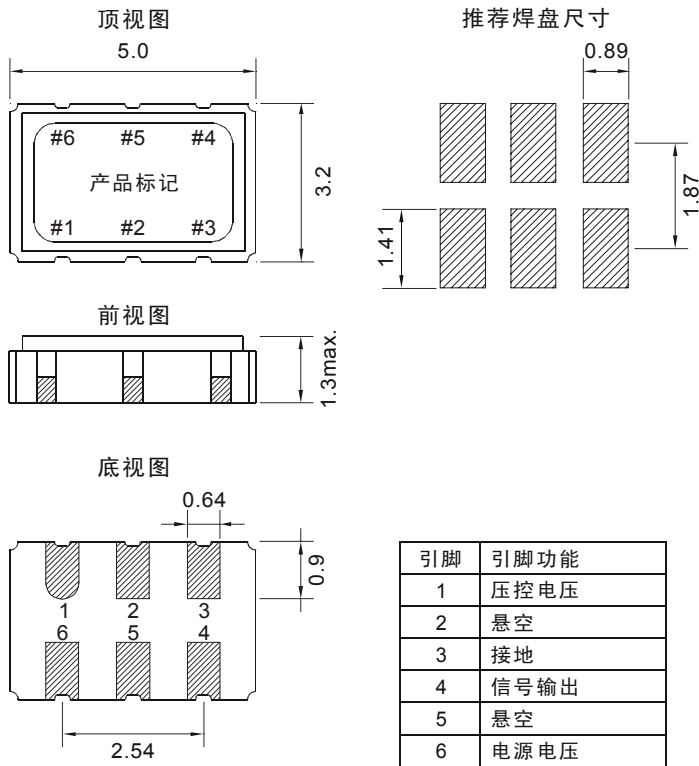
温度频率稳定度(表 1):

工作温度范围	频率稳定度(ppm)(Max)					
	±5	±10	±20	±25	±30	±50
B=-10℃~+60℃	√	√	√	√	√	√
C=-20℃~+70℃	C	√	√	√	√	√
D=-30℃~+75℃	C	√	√	√	√	√
E=-40℃~+85℃	×	C	√	√	√	√
H=-55℃~+85℃	×	×	C	C	√	√
S=-55℃~+125℃	×	×	×	×	C	√
备注: √: 可选指标; ×: 不可选指标; C: 待确认指标。						

技术规范:

总规范	GJB 1648A-2011
质量等级	普军级(C 级),军品级(B 级) 七专级(Q 级),宇航级(S 级)

封装尺寸:



单位: mm, 公差: ±0.20mm

如何确定型号:

示例型号: JXV-S23A-T30E3.3-100-153.600MHz

JXV-S23A	-	T	30	E	3.3	-	100	-	153.600MHz
封装	输出波形	温度稳定度	工作温度范围	工作电压	压控范围	标称频率			
贴片封装 5.0×3.2mm	T=CMOS,TTL	05=±5ppm 10=±10ppm 20=±20ppm 25=±25ppm 30=±30ppm 50=±50ppm	B=-10℃~+60℃ C=-20℃~+70℃ D=-30℃~+75℃ E=-40℃~+85℃ H=-55℃~+85℃ S=-55℃~+125℃	5=5.0V 3.3=3.3V 2.5=2.5V 1.8=1.8V	50=±50ppm 100=±100ppm 150=±150ppm 200=±200ppm	0.200MHz~ 200.000MHz			